

S2C-SMT 3.50/22/90LF 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

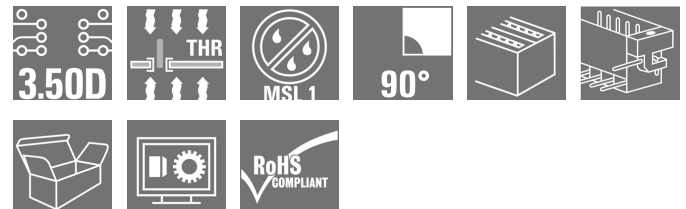


Abbildung ähnlich

Hochtemperaturfeste Stiftleiste

- fingersicher
- steckbar zu Buchsenstecker B2CF 3.50 PUSH IN
- **Steckrichtung senkrecht oder parallel zur Leiterplatte (180° / 90°)**
- Gehäusevarianten geschlossen (G) und mit Lötflansch (LF)
- **verpackt im Karton (BX) oder antistatisch im Tape-on-Reel (RL)**
- Für Reflow- und Wellenlötanwendungen geeignet
- Stiftlänge wahlweise 1,5 mm oder 3,2 mm

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box
Best.-Nr.	1289540000
Typ	S2C-SMT 3.50/22/90LF 3.2SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118082104
VPE	36 Stück
Produkt-Kennzahlen	IEC: 200 V / 13.4 A UL: 150 V / 10 A
Verpackung	Box

S2C-SMT 3.50/22/90LF 3.2SN BK BX
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Breite	45,5 mm	Breite (inch)	1,791 inch
Höhe	14 mm	Höhe (inch)	0,551 inch
Höhe niedrigstbauend	10,8 mm	Nettogewicht	9,528 g
Tiefe	14,2 mm	Tiefe (inch)	0,559 inch

Systemkennwerte

Produktfamilie	OMNIMATE Signal - Serie B2C/S2C 3.50 - 2-reihig	Anschlussart	Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte	THT/THR-Lötanschluss	Raster in mm (P)	3,5 mm
Raster in Zoll (P)	0,138 inch	Abgangswinkel	90°
Polzahl	22	Anzahl Lötstifte pro Pol	1
Lötstiftlänge (l)	3,2 mm	Lötstift-Abmessungen	d = 1,0 mm, oktogon
Bestückungsloch-Durchmesser (D)	1,3 mm	Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)	+ 0,1 mm
Außendurchmesser Lötauge	2,1 mm	Schablonenloch Durchmesser	1,9 mm
L1 in mm	35 mm	L1 in Zoll	1,378 inch
Anzahl Reihen	1	Polreihenanzahl	2
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106	fingersicher im Steckgesicht, handrücksicher oberhalb der Leiterplatte	Berührungsschutz nach DIN VDE 0470	IP 20
Kodierbar	Ja	Steckkraft/Pol, max.	3,5 N
Ziehkraft/Pol, max.	2,5 N		

Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP GF	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	IIIb
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-Leg
Kontaktoberfläche	verzinkt	Schichtaufbau - Lötanschluss	1...3 µm Ni / 2...5 µm Sn matt
Schichtaufbau - Steckkontakt	2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	120 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-40 °C
Temperaturbereich Montage, max.	120 °C		

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm	IEC 60664-1, IEC 61984	Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)	13,4 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)	12 A	Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2	200 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2	160 V	Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3	80 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2	2,5 kV	Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3	2,5 kV	Kurzzeitstromfestigkeit	3 x 1s mit 80 A

S2C-SMT 3.50/22/90LF 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Nennenden nach CSA

Institut (CSA)



Zertifikat-Nr. (CSA)

200039-1121690

Nennspannung (Use group B / CSA) 150 V

Nennspannung (Use group C / CSA) 50 V

Nennspannung (Use group D / CSA) 150 V

Nennstrom (Use group B / CSA) 9,5 A

Nennstrom (Use group C / CSA) 9,5 A

Nennstrom (Use group D / CSA) 9,5 A

Hinweis zu den Zulassungswerten

Angaben sind
Maximalwerte, Details
siehe Zulassungs-
Zertifikat.

Nennenden nach UL 1059

Institut (cURus)



Zertifikat-Nr. (cURus)

E60693

Nennspannung (Use group B / UL 1059) 150 V

Nennspannung (Use group C / UL 1059) 50 V

Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A

Nennstrom (Use group C / UL 1059) 10 A

Hinweis zu den Zulassungswerten

Angaben sind
Maximalwerte, Details
siehe Zulassungs-
Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung

Box

VPE Länge

30 mm

VPE Breite

135 mm

VPE Höhe

350 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0

EC002637

ETIM 7.0

EC002637

ECLASS 9.0

27-44-04-02

ECLASS 9.1

27-44-04-02

ECLASS 10.0

27-44-04-02

ECLASS 11.0

27-46-02-01

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität

Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.

Hinweise

- Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
- Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
- Reihenabstand siehe Lochbilder
- Zeichnungsangabe P = Raster
- Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
- Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate

Erstellungs-Datum 1. April 2021 05:36:37 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

S2C-SMT 3.50/22/90LF 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E60693

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Declaration of the Manufacturer
Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD

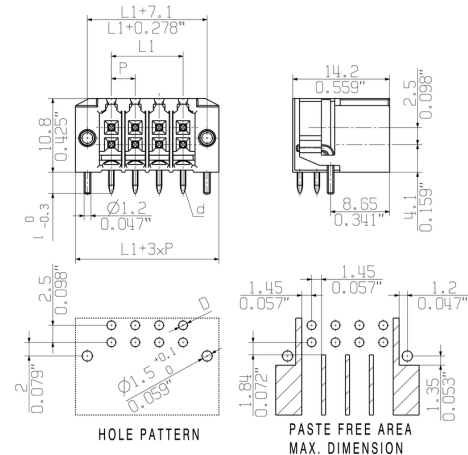
S2C-SMT 3.50/22/90LF 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßbild



The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmüller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Dimensions without tolerances are no check dimensions

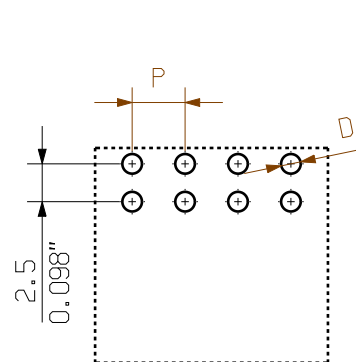
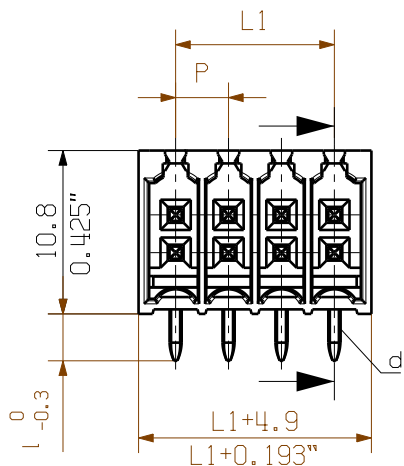
The English version is binding



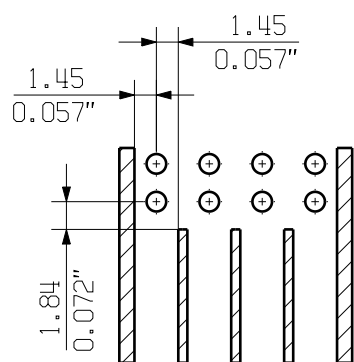
SHOWN: S2C-SMT 3.50/08/90G 3.2



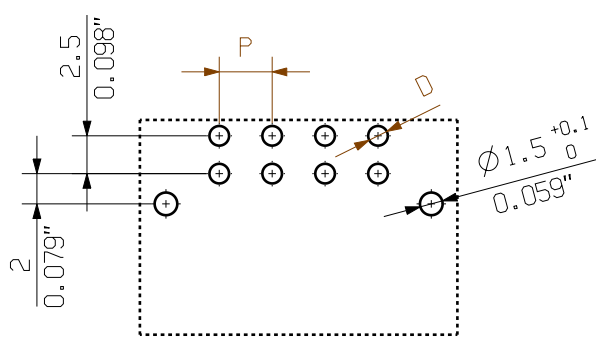
SHOWN: S2C-SMT 3.50/08/90LF 3.2



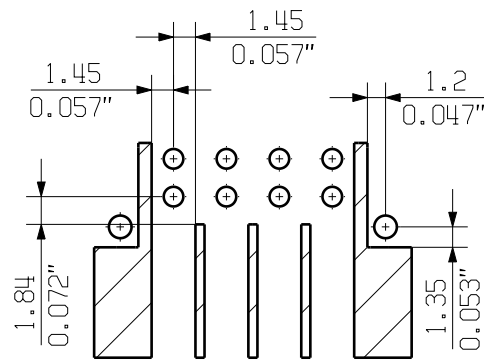
HOLE PATTERN



PASTE FREE AREA
MAX. DIMENSION



HOLE PATTERN



PASTE FREE AREA
MAX. DIMENSION

M 1/1
S2C-SMT 3.50/08/90G 1.5

M 1/1
S2C-SMT 3.50/08/90G 3.2

M 1/1
S2C-SMT 3.50/08/90LF 1.5

M 1/1
S2C-SMT 3.50/08/90LF 3.2



P = 3.50 RASTER
PITCH

D* = Ø1.3 +0.1
0.051"

d = 0.8x0.8
0.031"x0.031"

* from n (no of poles) 26
D = 1.4mm +0.1

S2C-SMT 3.50...180LF 3.5	3.5	0.126
S2C-SMT 3.50...180LF 1.5	1.5	0.059
S2C-SMT 3.50...180G 3.5	3.2	0.126
S2C-SMT 3.50...180G 1.5	1.5	0.059
TYP PART NAME	[mm]	[inch]

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application. Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

36	59.5	2.343	± 0.2	
34	56.0	2.205		
32	52.5	2.067		
30	49.0	1.929		
28	45.5	1.791		
26	42.0	1.654	± 0.15	
24	38.5	1.516		
22	35.0	1.378		
20	31.5	1.240		
18	28.0	1.102	± 0.1	
16	24.5	0.965		
16	24.5	0.965		
14	21.0	0.827		
12	17.5	0.689		
10	14.0	0.551		
8	10.5	0.413		
6	7.00	0.276		
4	3.50	0.138		
n	POLZAHL POLES	L1 [mm]	L1 [inch]	TOLERANZ TOLERANCE

Cat.no.: .

GENERAL TOLERANCE:
DIN ISO 2768-m

Max. nos.

99681/4
22.03.18 AMANN_A 01

Modification

Weidmüller

3 50160 **06**

Drawing no. Issue no.
Sheet 02 of 04 sheets



Date Name
15.07.2011 FRIELING_L

Responsible AMANN_A

Checked 04.04.2018 HELIS_MA

Approved LANG_T

Scale: 2/1

Supersedes: .

S2C-SMT 3.50/.../...
STIFTELEISTE
MALE HEADER

Product file: B2CF/S2C

7400

allgemeinguetliche Kundenzeichnung, aktueller Stand nur auf Anfrage
general customer drawing, topical version only if required

Empfohlene Wellen-Lötprofile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Einzelwelle:



Doppelwelle:



Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlüsselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezogene Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unter anderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von 260 °C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Reflow Lötprofil**

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt $\leq +3$ K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste „aktiviert“. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüssen auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei ≥ -6 K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.